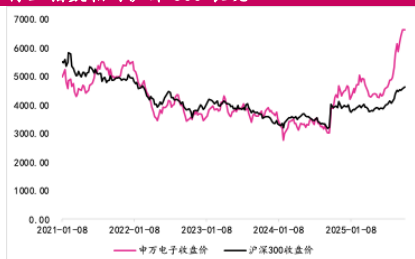


电子行业

2025年10月12日

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
灿芯股份	120.20	17.98	144.24
雅克科技	84.94	15.17	404.25
深科技	31.72	13.81	497.14
通富微电	45.60	13.52	692.02
旭光电子	18.97	13.25	157.45
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
太龙股份	18.55	-14.67	40.49
聚辰股份	140.60	-13.46	222.53
联芸科技	57.50	-12.61	264.50
方邦股份	60.55	-11.61	49.26
敏芯股份	97.56	-11.04	54.67

行业指数相对沪深300表现



相关报告

【金元电子】周报 20250815 光刻国产替代从0至1的“蓝海”，AI基础设施投入的“红海”均值得关注

【金元电子】周报 20250822 DeepSeek 迎来第二次“杰文斯效应”，应用侧或加速落地

【金元电子】周报 20250907 光通信产业链趋势未改，Scale-up/Scale-out/Scale-across、OCS 助力互连性能提升

【金元电子】周报 20250914 英伟达推出 Rubin CPX 加速推理性能，铜连接、光连接、功率需求高增

【金元电子】周报 20250921 HBM 高需求或抢占平面 DRAM 产能，供需错配致使存储涨价

【金元电子】周报 20250928 云栖大会看点多，硬件+平台开放助力国产 AI 芯片及模型落地

分析师：唐仁杰

执业证书编号：S0370524080002

电话：0755-83025184

邮箱：tangrj@jyzq.cn

行业周度点评报告

—AMD 与 OPENAI 达成 6GW 协议，开发互连技术 UALink 或加速渗透

评级：增持（维持）

- **全行业：**本周上证指数上涨0.37%，深证成指下跌1.26%，沪深300指数下跌0.51%，申万电子板块下跌2.63%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为30/31。板块个股涨幅前五名分别为：灿芯股份、雅克科技、深科技、通富微电、旭光电子；跌幅前五名分别为：太龙股份、聚辰股份、联芸科技、方邦股份、敏芯股份。
- **电子行业：**本周电子行业整体呈现多数板块下跌、少数板块上涨的格局，细分领域表现差异显著。从申万二级行业数据看，仅其他电子II实现0.25%的周涨幅，其余板块均下跌。其细分申万三级行业中，半导体板块内部分子板块表现相对突出，集成电路封测子板块涨幅达到1.57%，半导体材料涨幅达0.48%，成为板块内的增长亮点；元件板块表现不佳，其中印制电路板子板块跌幅为3.03%，被动元件微跌0.09%；光学光电子板块下，光学元件子板块跌幅为2.07%，表现较弱；消费电子板块中，品牌消费电子下跌3.69%，消费电子零部件及组装下跌2.59%；电子化学品板块整体表现不佳，其细分电子化学品III子板块跌幅达0.55%；其他电子板块下其他电子III取得0.25%的周涨幅，表现相对平稳。总体来看，电子行业本周多数板块及细分领域下跌，仅少数板块或子板块（如其他电子II、集成电路封测、半导体材料等）上涨，不同板块及细分领域间分化特征较为明显。
- **行业要闻**
 - ◆ 马斯克xAI正在推进约200亿美元融资，用于采购英伟达GPU
 - ◆ OpenAI与AMD宣布数百亿美元芯片大单，共同开发AI数据中心
 - ◆ 土地整治由17年缩短至2年，台积电高雄厂首批2nm晶圆产出
 - ◆ 矽光子元件新突破，imec展示110GHz超宽频C频段锗硅电致吸收调制器
 - ◆ 八年首见，DRAM模组厂威刚、十铨暂停报价
- **公司动态：**
 - ◆ 广钢气体：2025年半年度权益分派实施公告
 - ◆ 瑞联新材：持股5%以上股东减持股份计划公告
 - ◆ 胜宏科技：关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告
 - ◆ 艾比森：2025年半年度权益分派实施公告
 - ◆ 乾照光电：关于高级管理人员减持股份预披露公告
- **投资建议：**我们认为，AMD采用UALink解决方案有利于开放生态互连，或加速国内超节点内部互连进程，减轻对NVLink的依赖。UALink作为业界开放标准，与NVIDIA的专有NVLink技术在目标上类似，都是为了在单机和机群内部提供GPU之间的高带宽、低延迟互连。在性能方面，UALink单port/Link性能可达800Gbps（100GB/s），与NVLink 5单port/Link性能类似。但UALink胜在开放性和可扩展规模。通过开放标准，服务器厂商可以自由实现将数十上百GPU构成一组UALink域，例如72 GPU一组的架构，而不局限于NVIDIA 8-16 GPU一组的封闭设计。另外UALink采用现成200G SerDes技术，便于快速推进；NVLink则是NVIDIA内部协议，不与以太网标准兼容。我国企业加速布局UALink，以破局NVLink在GPU间低互连、高带宽的“垄断”。相关公司包括：兆龙互连（300913.SZ）、澜起科技（688008.SH）、紫光股份（000938.SZ）、盛科通信-U（688702.SH）、中兴通讯（000063.SZ）等。
- **风险提示：**1、AI应用落地不及预期：国内AI渗透率不及预期，导致基础设施投入不及预期；2、产业链风险：关键芯片生产难度较大，如SerDes，导致技术落地不及预期；3、技术风险：互连技术方案较多，导致较大竞争。

请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明

曙光在前 金元在先

目 录

一、核心观点	3
二、行业跟踪	10
三、行业新闻	12
四、公司公告	19
五、下周重要事件提示	22

图表目录

图 1: MI325X OAM vs H200 SXM	3
图 2: 单个 XCD 计算芯片内部结构	4
图 3: MI300A+GPU 统一封装	4
图 4: 基于 MI400 系列机柜级算力与英伟达 Vera Rubin 性能对比	5
图 5: AMD 加速卡互连结构	6
图 6: UALink 成员	8
图 7: 本周各行业版块涨跌幅	10
图 8: 本周电子版块: 子版块涨跌幅	11
图 9: 电子板块历史走势	12
图 10: 电子板块历史市盈率	12
表 1: 本周电子板块个股涨幅前五名	10
表 2: 本周电子版块个股跌幅前五名	10
表 3: 下周重要会议	22
表 4: 电子行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)	24

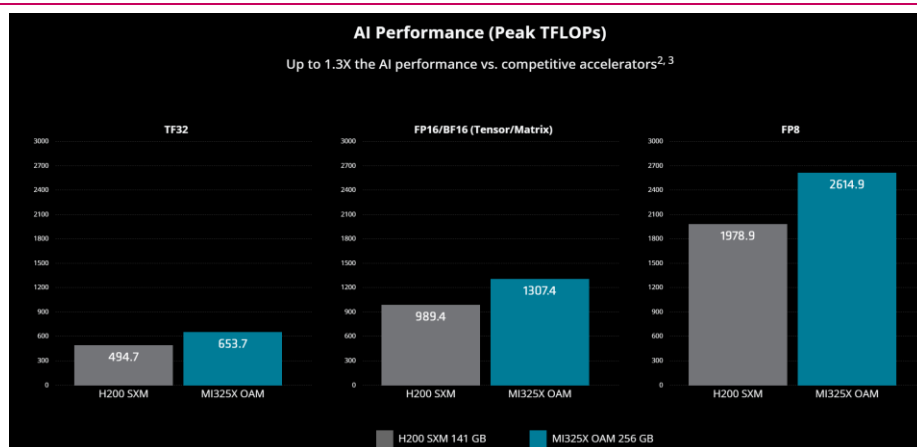
一、核心观点

2025 年 10 月 6 日，AMD 和 OpenAI 宣布达成一项 6 吉瓦协议，为跨多代 AMD Instinct GPU 的 OpenAI 下一代 AI 基础设施提供动力。AMD Instinct MI450 GPU 的首批 1 GB 部署将于 2026 年下半年开始。根据最终协议，OpenAI 将 AMD 作为核心战略计算合作伙伴合作，推动 AMD 技术的大规模部署，从 AMD Instinct MI450 系列和机架级 AI 解决方案开始，并扩展到未来几代。

MI300 系列采用台积电 5nm 工艺制造 GPU 芯片，并辅以 6nm 工艺的 I/O 芯片。以旗舰 MI300X 为例，其 GPU 部分拥有 304 个 CDNA3 计算单元（CUs），晶体管数高达 1530 亿，搭载总容量 192GB 的 HBM3 内存（8 堆，每堆 24GB），峰值内存带宽约 5.2 TB/s。MI300A 则在单封装内集成了 24 核 Zen 4 CPU（3 个 8 核 CCD）和 6 颗 GPU 计算芯片（228 个 CU 核心），配备 128GB HBM3，晶体管数约 1460 亿。

两者的 Infinity Fabric 芯片间带宽均约 896 GB/s。在功耗方面，MI300X 加速卡热设计功耗（TDP）高达 750W（OAM 模块规格允许最高 1000W）。MI300X 在矩阵运算方面引入了 Matrix Core 矩阵加速单元，支持包括 INT8、FP8 等低精度 AI 数据格式（含稀疏优化）以及 FP16/BF16，并保留对 HPC 所需 FP64 双精度的完整支持。据 AMD 公布的数据，MI300X 单卡峰值达到约 2600 TFLOPS（2.6 PFLOPS）的 FP8 算力，以及约 1300 TFLOPS 的 FP16/BF16 算力。MI325X 算力方面与 MI300X 相同，两者都基于 CDNA 3 GPU 架构构建，但是在内存方面，MI300X 配备 192GB HBM3，而 MI325X 在每个 GPU 上配备 256GB HBM，且从 HBM3 升级到 HBM3E。AI 性能方面，MI325X OAM 性能在不同精度下高于 H200 SXM。

图 1：MI325X OAM vs H200 SXM

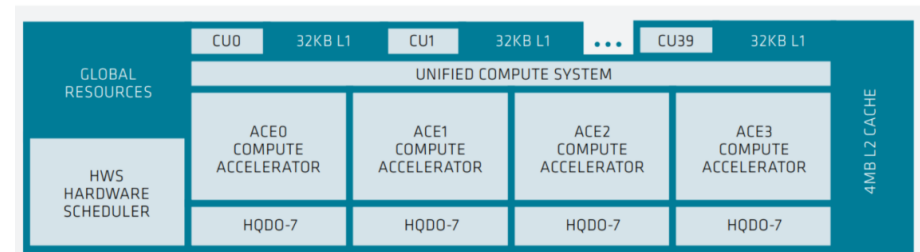


数据来源：AMD，金元证券研究所

CDNA3 架构在 MI300 上实现了一系列革新，利用 Chiplet 小芯片和 3D 垂直堆叠技术，将计算、缓存、内存紧密耦合。每颗 XCD 计算芯片内含 40 个 CUs（38 个激活+2 备份），共享 4MB L2 缓存，并内置改良的 Matrix Core 阵列运算单

元。8 个 XCD 通过 Infinity Fabric 高速互连总线组成统一 GPU，一个 MI300X 加速器对系统呈现为单一 GPU 处理器。MI300 系列还引入了 256MB Infinity Cache 三级缓存和改进的内存层次结构，以充分喂饱庞大的计算单元。

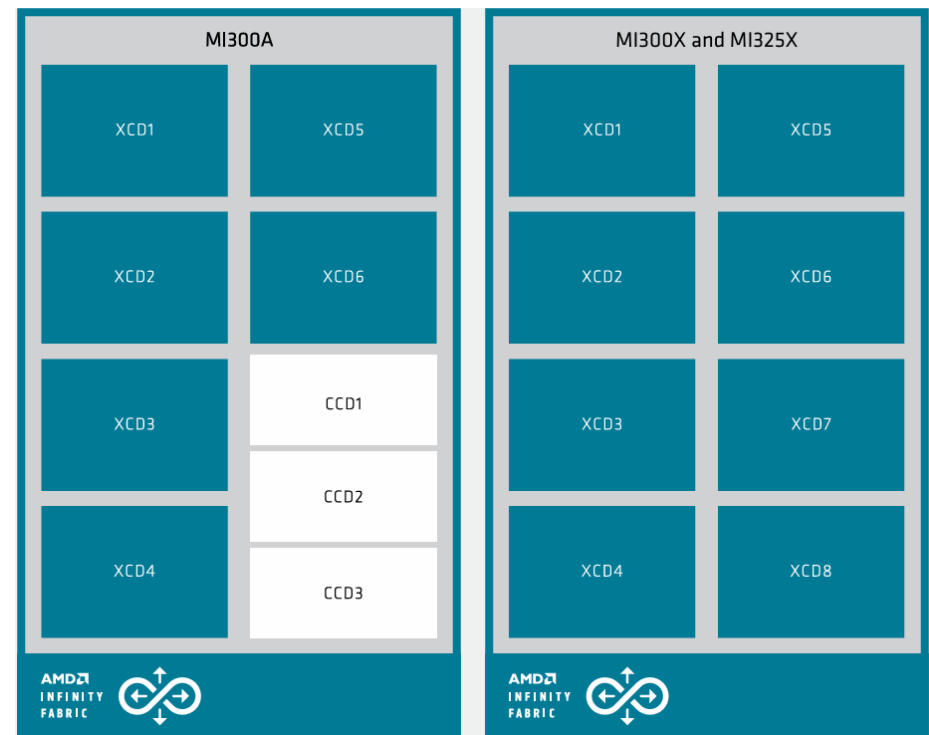
图 2：单个 XCD 计算芯片内部结构



数据来源：AMD，金元证券研究所

另一方面，MI300A APU 将 CPU 计算芯片（CCD）也集成在同一封装，通过一致性 Infinity Fabric 实现 CPU 与 GPU 的高速互连和统一内存寻址。CPU 和 GPU 共同共享 HBM 高带宽内存，实现真正的异构融合计算，加速传统 HPC+AI 融合工作负载

图 3：MI300A+GPU 统一封装



数据来源：AMD，金元证券研究所

Instinct MI400 系列将采用代号“CDNA Next”（可能命名为 CDNA4 或称 UDNA）的新架构，预计在 2026 年推出。虽然 MI400 系列具体细节尚未全面公开，但根据 AMD 称，2025 年先推出的 MI350 系列（CDNA 4 架构）相较 MI300 将有多

达 35 倍的 AI 推理性能提升。MI400 系列预计将集成 432 GB HBM4 内存（比 MI350 的 288GB 提高 50%），HBM4 带宽高达 19.6 TB/s，约为 MI350 时代 HBM3e 的 2.5 倍。计算性能方面，MI400 的 AI 算力据称相比 MI350 再翻一番——官方给出的性能是 FP4 精度 40 PFLOPS、FP8 精度 20 PFLOPS，约为 MI350X 的一倍。AMD 白皮书中对比了基于 MI400 系列的机柜“Helios”与英伟达的 Vera Rubin，在存储容量、带宽以及 Scale out 带宽方面更胜一筹。

图 4：基于 MI400 系列机柜级算力与英伟达 Vera Rubin 性能对比

AMD “Helios” AI Rack		
Rack Scale AI Performance Leadership		
	AMD Instinct™ MI400 Series “Helios”	vs. Vera Rubin Oberon
GPU DOMAIN	72	1.0x
SCALE UP BANDWIDTH	260 TB/s	1.0x
FP4 • FP8 FLOPS	2.9 EF • 1.4 EF	1.0x
HBM4 MEMORY CAPACITY	31 TB	1.5x
MEMORY BANDWIDTH	1.4 PB/s	1.5x
SCALE OUT BANDWIDTH	43 TB/s	1.5x

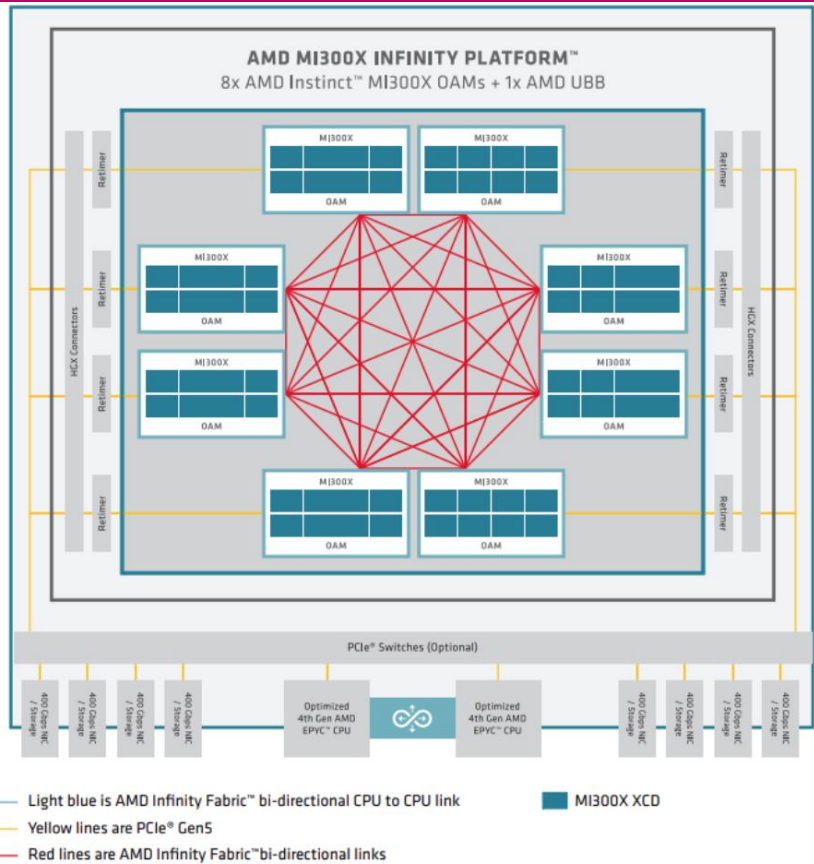
数据来源：AMD，金元证券研究所

AMD 在 MI300 时代提出了面向数据中心的大规模机柜级部署方案，涵盖从单服务器节点到整柜集群的设计参考。其核心是采用多 GPU 加速计算节点作为基本单元，并通过高速网络将众多节点按架构拓扑连接，实现规模化的算力提供。

多 GPU 计算节点布局。AMD 推荐的计算节点通常由 8 块 MI300 系列 GPU 加速卡组成，采用开放加速模块（OAM）规格安装在统一基板（UBB）上，通过第四代 Infinity Fabric Link 互连成一个紧耦合的 GPU 组。同时，每节点还包括一到两颗主机 CPU（通常是双路 EPYC 处理器）以及必要的内存和高速网卡。典型设计中，8 块 GPU 呈全互联拓扑，即每 GPU 直接与其它 7 个 GPU 都有高速链路相连形成无阻塞的 8 路网格/全连通拓扑。

AMD Infinity Fabric Link 在 MI300X 上每条链路带宽约 50 GB/s，每 GPU 有 7 条此类链路直连其他 GPU，因此组内任意两 GPU 通信无需经过中间跳数，单跳即可达到 50 GB/s 带宽。这种拓扑有效降低了延迟（典型 GPU 直连延迟仅数百纳秒级），避免了传统 PCIe 交换通信的瓶颈。如下图所示，一个 8×MI300X 节点的 GPU 内部通过红色线的 Infinity Fabric 构成全连接，同时每块 GPU 通过 PCIe 5.0×16 通道（黄色线）连接到 CPU 和网络接口，实现与外部的通信。

图 5：AMD 加速卡互连结构



数据来源：AMD，金元证券研究所

MI300 系列由于功耗极高，散热方案成为部署关键。AMD 及其合作伙伴提供了多种冷却选项，包括高效风冷、直接液冷（DLC）以及浸没式冷却等。其中直接液冷（Direct-to-Chip Liquid Cooling）最为常见，即为每块 GPU 加速器

和 CPU 安装定制冷板，通入冷却液将热量带走。上述 2U MI300A 液冷系统就是通过直连冷板为 4 颗 APU 散热，实现高达 760W×4 的热设计功耗处理

网络与拓扑方面，在机柜/集群层面，AMD 推荐划分前端网络、加速器（GPU）内部网络和后端扩展网络三类。其中前端网络指传统以太网或 InfiniBand，用于存储访问和管理流量；加速器网络即上述节点内 Infinity Fabric Link 网

构成的 8 GPU 高速互连域。后端网络则负责连接跨节点的 GPU 通信，每节点配置 8 块高速 NIC（如 400 GbE），通过 Top-of-Rack 交换机和多级网络组成大规模集群。

AMD 采用标准以太网络技术来构建后端 GPU 通信网，但加入了一些优化。每 GPU 配备专属 NIC，实现 GPU 直连网络；使用 RDMA over Converged Ethernet (RoCE) 协议和拥塞管理，以及可在 NIC 上加速处理 All-Reduce 等集合通信的功能。例如 Pollara 400Gb/s 以太网适配卡与 MI300GPU 通过 PCIe 5.0 接口相连，为每个 GPU 提供等效于 NVIDIA InfiniBand NDR 的带宽，并能与 Ultra Ethernet 框架配合实现更低延迟。这种设计理念类似于将网络功能“下沉”到每 GPU，使 GPU 间跨节点通信尽可能并行、低延时。实际拓扑上，

经常采用 Fat-Tree 双层或三层架构连接上千甚至上万颗 GPU 节点。综合来看，AMD 的机柜级部署方案强调节点内高速直连+节点间大带宽分布式互联，辅以先进的液冷散热，旨在充分释放每瓦功耗所提供的计算潜能。

随着 GPU 数量的激增，传统网络已难以满足 GPU 间通信的极端需求。为此，AMD 布局了一系列互连技术，包括收购 Pensando 公司推出数据处理单元(DPU)以及主导推动 UA Link (Ultra Accelerator Link) 开放互连协议，以建立高带宽、低延迟、可扩展的 GPU 互连生态。

在集群方案中，Pensando DPU/SmartNIC 扮演两个重要角色：其一，提供超高带宽网络接口（如 Pensando Pollara 400 Gb/s 以太网卡）连接每块 GPU 到集群交换机，实现每 GPU 400G 的后端网络吞吐；其二，在网络层执行智能化的通信加速，如 P4 可编程数据面可以优化 GPU 间的 All-to-All、All-Reduce 等常用通信模式，降低 MPI/通信库开销。

这一点类似于 NVIDIA Mellanox BlueField DPU 在 InfiniBand 中的作用。简单来说，Pensando DPU 使 AMD GPU 集群可以在标准以太网上达到接近 InfiniBand 级的性能，同时保持以太网络的开放标准和广泛兼容性。随着云厂商对“可编程网络”和“零信任安全”的需求增长，Pensando DPU 在提供 GPU 加速的同时还能加强网络隔离和安全策略，实现一举多得。例如微软 Azure 已经在网络中大规模部署 Pensando DPU 来加速其数据中心网络，这也为将来 AMD GPU 在云中的应用铺平了道路。

UA Link (Ultra Accelerator Link) 是由 AMD 牵头、多家公司参与制定的开放式加速器互连标准。其目标是为 GPU/AI 加速器提供大规模扩展的统一内存语义互连。UA Link 本质上源自 AMD 多年发展的 Infinity Fabric 协议，并针对开放生态进行了优化。

根据 UA Link Consortium 公布的 1.0 规范，UA Link 采用 200 Gbps/lane 的物理层（与以太网 PHY 等价），通过 4 条 lane 组成 800 Gbps（双向总计）链路，相当于每 Link 接近 100 GB/s 的带宽，单 link/port 与 NVLink 5 一致。更重要的是，UA Link 是存储器语义的互连，即连接域内的 GPU 之间可以直接执行 load/store 和原子操作访问彼此显存，在云端计算背景下，本地共享内存池。目前，包括 AMD、Astera Labs、Marvell 等公司都在开发 UA Link 交换芯片和接口 IP，旨在 2025-2026 年左右推出商业产品，以支持 MI400/MI500 时代 GPU 的互连需求。

值得注意的是，2025 年之前 AMD 的方案仍主要依赖 Infinity Fabric over Ethernet (IFoE) 来实现跨节点通信（实质是用以太网封装的缓存一致通信），并一度将其定义为“UA Link over Ethernet”。但真正的原生 UA Link 互连将在硬件交换机就绪后随 MI400 系列问世，用专有链路和交换设备取代当前的以太网方案，届时 AMD 将能够提供类似 NVIDIA NVLink / NVSwitch 那样的大规模直连加速器网络，且是开放标准、多厂商生态的。

UALink 作为业界开放标准，与 NVIDIA 的专有 NVLink 技术在目标上类似，都是为了在单机和机群内部提供 GPU 之间的高带宽、低延迟互连。在性能方面，UALink 单 port/Link 性能可达 800Gbps(100GB/s)，与 NVLink 5 单 port/Link 类似。但 UALink 胜在开放性和可扩展规模。通过开放标准，服务器厂商可以自由实现将数十上百 GPU 构成一组 UALink 域，例如 72 GPU 一组的架构，而不局限于 NVIDIA 8-16 GPU 一组的封闭设计。另外 UALink 采用现成 200G SerDes 技术，便于快速推进；NVLink 则是 NVIDIA 内部协议，不与以太标准兼容。我国企业加速布局 UaLink，以破局 NVLink 在 GPU 间低互连、高带宽的“垄断”。由于 UALink 是开放架构，阿里巴巴、摩尔线程、芯耀辉、字节跳动、新华三、摩尔线程、澜起科技、中兴通讯等均是 UALink 成员之一。

图 6：UALink 成员



数据来源：Ultra Accelerator Link，金元证券研究所

我们认为，AMD 采用 UALink 解决方案有利于开放生态互连，或加速国内超节点内部互连进程，减轻对 NVLink 的依赖。UALink 作为业界开放标准，与 NVIDIA 的专有 NVLink 技术在目标上类似，都是为了在单机和机群内部提供 GPU 之间的高带宽、低延迟互连。在性能方面，UALink 单 port/Link 性能可达 800Gbps (100GB/s)，与 NVLink 5 单 port/Link 性能类似。但 UALink 胜在开放性和可扩展规模。通过开放标准，服务器厂商可以自由实现将数十上百 GPU 构成一组 UALink 域，例如 72 GPU 一组的架构，而不局限于 NVIDIA 8-16 GPU 一组的封闭设计。另外 UALink 采用现成 200G SerDes 技术，便于快速推进；NVLink 则是 NVIDIA 内部协议，不与以太标准兼容。我国企业加速布局 UALink，以破局 NVLink 在 GPU 间低互连、高带宽的“垄断”。

相关公司包括：兆龙互连（300913.SZ）、澜起科技（688008.SH）、紫光股份（000938.SZ）、盛科通信-U（688702.SH）、中兴通讯（000063.SZ）等。

风险提示：

1、AI 应用落地不及预期：

国内 AI 渗透率不及预期，导致基础设施投入不及预期

2、产业链风险：

关键芯片生产难度较大，如 SerDes，导致技术落地不及预期

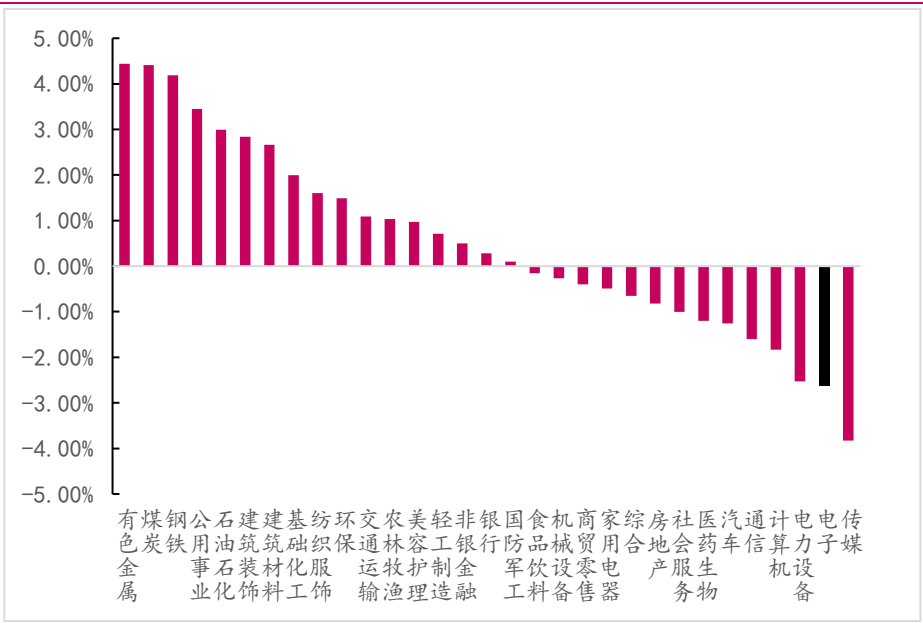
3、技术风险：

互连技术方案较多，导致较大竞争。

二、行业跟踪

全行业：本周（2025.10.06–2025.10.10）本周上证指数上涨 0.37%，深证成指下跌 1.26%，沪深 300 指数下跌 0.51%，申万电子版块下跌 2.63%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 30/31。板块个股涨幅前五名分别为：灿芯股份、雅克科技、深科技、通富微电、旭光电子；跌幅前五名分别为：太龙股份、聚辰股份、联芸科技、方邦股份、敏芯股份。

图 7：本周各行业版块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
688691.SH	灿芯股份	17.98	120.20	110.00	135.81	52.86	37.78	46.85
002409.SZ	雅克科技	15.17	84.94	77.89	86.66	20.64	65.75	54.88
000021.SZ	深科技	13.81	31.72	28.21	32.94	35.88	562.24	171.54
002156.SZ	通富微电	13.52	45.60	44.19	47.99	22.48	341.13	157.64
600353.SH	旭光电子	13.25	18.97	17.46	19.39	20.53	170.12	31.69

数据来源：Choice，金元证券研究所

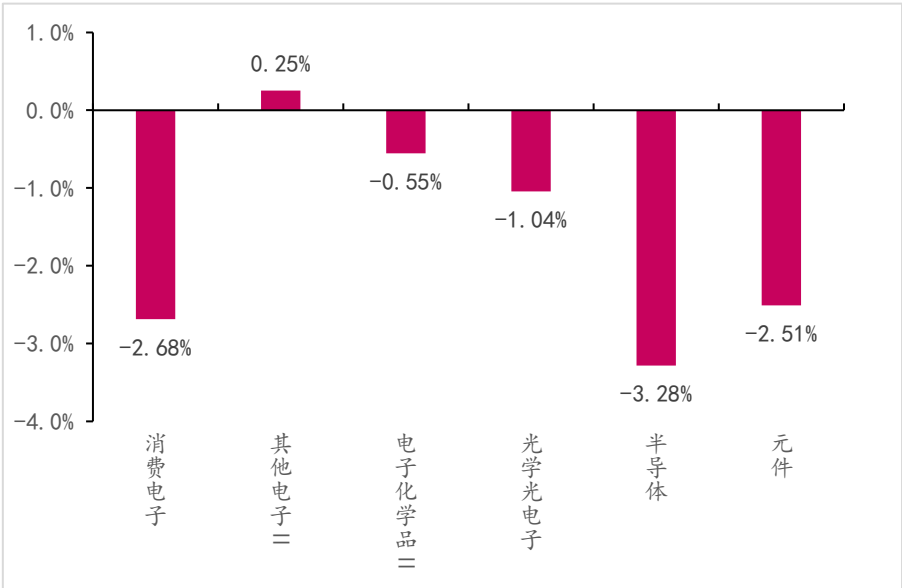
表 2：本周电子版块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
300650.SZ	太龙股份	-14.67	18.55	18.32	22.08	34.16	58.19	11.66
688123.SH	XD 聚辰股	-13.46	140.60	139.20	166.60	24.14	38.21	57.56
688449.SH	联芸科技	-12.61	57.50	57.01	69.00	34.98	24.49	15.24
688020.SH	方邦股份	-11.61	60.55	60.13	72.60	12.28	9.99	6.61
688286.SH	敏芯股份	-11.04	97.56	96.65	109.10	12.71	7.12	7.35

数据来源：Choice，金元证券研究所

电子行业：本周(2025. 10. 06-2025. 10. 10)电子行业整体呈现多数板块下跌、少数板块上涨的格局，细分领域表现差异显著。从申万二级行业数据看，仅其他电子II实现0.25%的周涨幅，其余板块均下跌。其细分申万三级行业中，半导体板块内部分子板块表现相对突出，集成电路封测子板块涨幅达到1.57%，半导体材料涨幅达0.48%，成为板块内的增长亮点；元件板块表现不佳，其中印制电路板子板块跌幅为3.03%，被动元件微跌0.09%；光学光电子板块下，光学元件子板块跌幅为2.07%，表现较弱；消费电子板块中，品牌消费电子下跌3.69%，消费电子零部件及组装下跌2.59%；电子化学品板块整体表现不佳，其细分电子化学品III子板块跌幅达0.55%；其他电子板块下其他电子III取得0.25%的周涨幅，表现相对平稳。总体来看，电子行业本周多数板块及细分领域下跌，仅少数板块或子板块（如其他电子II、集成电路封测、半导体材料等）上涨，不同板块及细分领域间分化特征较为明显。

图 8：本周电子版块：子版块涨跌幅

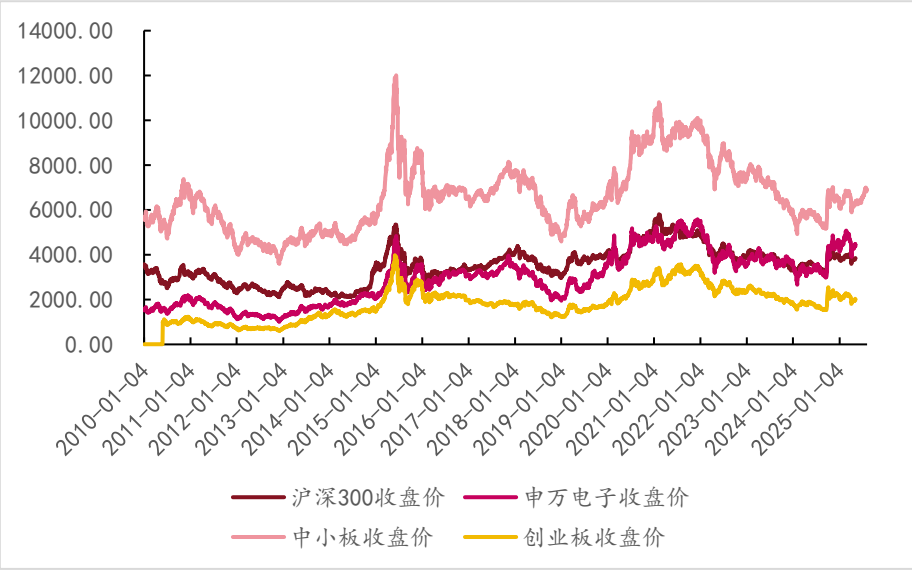


申万二级行业	周涨跌幅	申万三级行业	周涨跌幅
半导体	-3.28%	分立器件	-1.86%
		半导体材料	0.48%
		数字芯片设计	-4.41%
		模拟芯片设计	-3.70%
		集成电路封测	1.57%
		半导体设备	-1.53%
元件	-2.51%	印制电路板	-3.03%
		被动元件	-0.09%
光学光电子	-1.04%	面板	-0.39%
		LED	-1.28%
		光学元件	-2.07%

消费电子	-2.68%	品牌消费电子	-3.69%
		消费电子零部件及组装	-2.59%
电子化学品	-0.55%	电子化学品Ⅲ	-0.55%
其他电子	0.25%	其他电子Ⅲ	0.25%

数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 9: 电子板块历史走势



数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 10: 电子板块历史市盈率



数据来源: Choice, 金元证券研究所

三、行业新闻

美国FCC拟加强对华通信设备监管

10月6日据路透社报道,美国联邦通信委员会(FCC)拟于本月28日投票通过新

规，进一步限制中国通信设备在美的销售与授权。计划包括撤销已授权设备、禁止含高风险组件的新品进入市场，并扩大对华企通信设备的安全审查范围。报道指出，此举是美国近年来在通信与电子设备领域对中国加强出口/进口审查政策的一环，意在加强对关键基础设施安全的把控。

A股3300亿光伏巨头阳光电源正式递表港交所

10月6日据21世纪经济报道报道，阳光电源股份有限公司向港交所提交上市申请书，独家保荐人为中金公司。阳光电源此前于8月25日公告表示，为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，打造公司多元化融资渠道，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司于10月1日发布2025年第二次临时股东会决议公告，公司9月30日召开的股东会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。不同于一体化组件厂商，由于业务结构的差异，阳光电源是今年上半年少数实现逆势发展的光伏行业企业之一。据阳光电源解释，主要盈利贡献来自于光伏逆变器、储能业务和新能源投资开发。

射频前端国产替代，昂瑞微扮演重要角色

10月6日据半导体行业观察报道，今年3.28日昂瑞微科创板IPO申报获得受理，这在射频前端行业是个重大事件，经过最近几年发展，昂瑞微业绩发展迅速，2024年销售额赶上唯捷创芯，成功跻身射频前端第一梯队，与唯捷创芯一道率先推出射频前端中最难的Sub3G L-PAMiD产品，并在头部品牌手机终端客户旗舰机型量产，填补射频前端最关键的一块短板。据昂瑞微披露资料，其在卫星通信和车载电子等应用的射频前端市场也有较大进展，5G接收模组也在头部品牌手机终端量产，补齐5G射频前端拼图。

三星CIS重获苹果订单

10月6日据半导体行业观察报道，三星的CMOS感光元件（CIS）将重返苹果供应链。CIS是智能型手机相机模组的核心芯片，可将光线转换为电子讯号并输出影像。目前旗舰iPhone将配备一颗前置CIS与三颗后置CIS，其中一颗后置镜头将由三星提供。市场估算，此CIS产品不仅可能应用于新款iPhone，也将涵盖仍在销售的旧款机型，潜在需求量约达2亿颗。以12吋晶圆、80%良率推算，苹果目前对三星的订单仅约占最大需求的20%。然而，三星原本规划于2026年3月启动量产，但最新评估显示可能推迟至2026年底或2027年初。

帝科股份声称以技术创新，服务国家新能源与半导体战略自主自强

10月6日据人民财讯报道，帝科股份目前聚焦功率半导体封装浆料与汽车电子浆料等关键环节，进行国产替代突破，旨在打破德国汉高、贺利氏、美国alpha等企业的垄断。为了实现半导体封装材料与半导体器件的协同发展，帝科股份2024年引入存储半导体行业资深团队，顺利切入存储这一半导体核心领域，该团队长期专注于DRAM存储芯片的应用性开发设计、方案设计，未来将凭借独特技术优势助力我国存储行业打破国外垄断，促进国内存储行业快速发展满足AI、大数据、5G与自动驾驶等核心战略领域对于存储芯片持续增长的需求。

以自主研发为本，努力成为高端专用功能性湿电子化学品领域行业领军品牌

10月7日据人民财讯报道，天承科技产品广泛应用于印制电路板、封装基板、半导体、显示面板等多个领域。在印制线路板、封装基板领域，公司与国际竞争对手并驾齐驱，产品与技术服务在行业中广受好评。尤其在聚酰亚胺、PET树脂、ABF材料表面的金属化技术方面，公司产品性能稳定，获得了主流封装载板厂和顶级OEM的认可。公司在半导体封装及先进制程领域的再布线层RDL、凸点Bumping、硅通孔TSV、大马士革电镀系列产品也得到了知名封装厂的肯定，性能达到国际先进水平。顺应高性能计算和人工智能的发展趋势，公司迅速投入玻璃基板通孔TGV金属化技术的研发，并已获得产业链的广泛认可。同时与顶级OEM企业建立了深入合作关系，共同推动产业化进程。

中微超7亿参设基金、长川收购子公司，国产半导体设备势头正盛

10月7日据全球半导体观察报道，中微公司参与出资的智微资本首期基金，上海智微攀峰创业投资合伙企业宣布启动，将正式进入投资期。该基金募资规模暂定15亿元，首期6亿元已完成实缴，由智微资本作为管理人、普通合伙人、执行事务合伙人，拟认缴出资1500万元，占比约1%。中微临港作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资不超过7.35亿元，占基金总规模的比例不超过49%，为基金第一大出资方。此外，上海科技创业投资有限公司、上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金等10余家机构合伙人也同步参与。该基金聚焦半导体及泛半导体产业链，包括集成电路、先进封装、LED外延片等核心环节，同时覆盖战略新兴产业的相关企业。

2024年中国购入380亿美元先进制程设备，出口管制协同待加强

10月7日据路透社报道，美国众议院对华特别委员会称，2024年中国从美、日、荷供应商处购入约380亿美元的半导体制造设备，显示多边管控存在空隙。报告点名ASML、东京电子、应用材料、泛林、科磊等企业在华销售额占比高，建议盟友进一步对齐规则。这或影响未来一段时间的前道设备与中国本土替代节奏。

马斯克xAI正在推进约200亿美元融资，用于采购英伟达GPU

10月7日据路透社转引彭博报道，马斯克的xAI接近完成一笔高达200亿美元的股债结合融资，英伟达拟出资约20亿美元参与，资金将用于采购用于Colossus 2数据中心的高端GPU。若成行，AI算力资本开支在10月继续显著升温，带动HPC服务器、光模块、先进封装等链条的需求延续高景气。

OpenAI与AMD宣布数百亿美元芯片大单，共同开发AI数据中心

10月8日爱集微消息，OpenAI和AMD宣布达成一项价值数百亿美元的合作协议，共同开发基于AMD处理器的AI数据中心，这是迄今为止对行业领军企业英伟达构成的最直接挑战。根据该协议的条款，AMD将在为期四年的协议中，向OpenAI提供数十万块人工智能芯片。OpenAI承诺将购买价值6吉瓦的AMD芯片，从明年开始将首先购买MI450芯片。OpenAI将直接购买这些芯片，或者通过其云计算合作伙伴进行采购。协议还显示，OpenAI与AMD将作为核心战略计算合作伙伴，共同推动AMD技术的大规模部署。合作将从AMD Instinct MI450系列及

机架级AI解决方案开始，并扩展到未来产品世代。双方将共享技术专长，以优化产品路线图，从而深化自MI300X及MI350X系列以来的多世代软硬件合作。此外，AMD还向OpenAI发行了认股权证，允许其基于“实现特定股价目标”及OpenAI实际部署芯片的进度，在未来以每股0.01美元的行权价购入最多1.6亿股公司股票。

土地整治由17年缩短至2年，台积电高雄厂首批2nm晶圆产出

10月8日爱集微消息，中国台湾高雄政府10月6日表示，台积电高雄F22厂试产的首批12英寸2nm晶圆顺利产出，宣告台积电高雄厂2nm投产进度超前，预估该厂初期年产值将逾1500亿元新台币，并且会在楠梓扩展至五座厂。台积电高雄厂2nm制程晶圆试产成功，高雄市长陈其迈收到台积电董事长魏哲家署名、编码“K1A001.00的”纪念晶圆，直言心情“百感交集”，并预告先进半导体新时代来临，高雄正崛起。特别的是，魏哲家在致赠陈其迈的纪念晶圆中题了一首诗，诗云：“大鹏展翅开新局，南方沃土育英才。方圆千里共协力，新猷开拓展鸿图。矽晶聚才谋发展，谷地生金富庶来。”藏头诗巧妙串连“大南方新矽谷”，寓意高雄成为半导体核心基地的愿景。陈其迈说，高雄能成为全球半导体最先进制程聚落，离不开市民支持、政府部门政策、台积电投资与市府团队努力，这份纪念晶圆不仅具历史意义，更将激励市府持续建构完整半导体产业链。

矽光子元件新突破，imec展示110GHz超宽频C频段锗矽电致吸收调变器

10月8日电子时报消息，比利时微电子研究中心（imec）宣布成功展示一款频宽超过110GHz的C频段锗矽（GeSi）电致吸收调变器（electro-absorption modulator，简称为EAM），该元件在imec研发的12吋矽光子平台上制造。Imec表示，新的调变器达到每通道400Gb/s的网路传输率，并为紧凑设计、低延迟和高能源效率进行优化，为新一代光学强度调变直接侦测（IM/DD）链路建立基础，这些链路透过简易且具成本效益的方式为资料中心机架与刀锋伺服器建立互连。这项技术将是满足AI应用需求的关键，这些应用仰赖更快速、更高效的机器学习训练。Imec指出，人工智慧（AI）应用，还有驱动这些应用的机器学习（ML）训练，需要能够几乎即时响应来交换巨量资料的运算架构。要满足这项挑战就需要在资料中心机架和刀锋伺服器之间建立短距离且垂直扩展型的内连，提供最小延迟与单通道400Gb/s的位元传输率（现已普遍当作为未来就绪的部署基准。）由电致吸收调变器驱动的光学IM/DD链路成为新兴的关键推手。设于根特大学的imec研究团队的IDLab实验室研究员Cedric Bruynsteijn解释，开发正确的调变器来协助这些光学IM/DD链路一直是一大研究重点，因为常用的技术选项都有缺点。举例来说，薄膜铌酸锂Mach-Zehnder调变器（MZM）提供绝佳的线性度、低光学损耗和超高频宽，但其占版面积大且面临污染挑战，使其与先进CMOS逻辑元件的晶圆级整合受阻，挑战其在共封装光学元件（CPO）与光学I/O的未来应用。

高通并开源软硬体公司Arduino，整合AI与边缘运算，强化开发者生态

10月8日电子时报消息，高通宣布达成协议，将收购全球领先的开源硬体和软体公司Arduino，此次交易将加速高通技术赋能开发者的策略，透过边缘技术及产品组合的使用权，让开发者更容易进行创新。高通表示，此次收购以高通

近期对 Edge Impulse 和 Foundries.io 的整合为基础，进一步显示了高通为各行各业开发者赋予更多开发能力的承诺。目前交易的完成仍须取得监管机构批准及其他惯例交割条件。高通指出，透过结合高通技术领先的处理、图形、电脑视觉及 AI 技术，以及 Arduino 的简单性、平易近人与社群精神，有望大幅提升各产业开发者的生产力。Arduino 将保留其开放的理念与社群精神，同时开启完整的开发平台 Arduino UNO Q 将作为这一新平台的第一步。同时，Arduino 也发表全新 UNO Q，这是首款搭载高通 Dragonwing QRB 2210 晶片的 Dual-Brain 开发板，它将高性能 Linux 计算与即时微控制器的操控相结合，为智慧家居、工业自动化等领域实现「瞬时 AI」的愿景。

ChatGPT整合應用程式已上线，OpenAI提出Apps SDK打造應用程式商店

10月8日电子时报消息，ChatGPT用户规模持续扩增，现在每周已有8亿使用者。在6日登场开发者大会 OpenAI DevDay 2025 上，OpenAI 宣布将多款应用程序引进 ChatGPT，如 Spotify、Canva、Expedia 等整合在 ChatGPT 对话中以提供服务。当使用者在 ChatGPT 里提及某一款应用程序，ChatGPT 会提醒可连接应用程序并选择要分享哪些资料，接着使用者能以自然对话方式与应用程序互动、完成自身需求。比方说，要求 Spotify 建立特定音乐人、曲风的播放清单，要求Canva直接建立、编辑或预览用于广告促销的视觉设计，要求Expedia提供特定期间在旅游目的地的住宿选择，包含免费版以及ChatGPT Go / Plus / Pro 订阅用户已能使用。过往我们需要开启 Spotify、Canva、Expedia等应用程序或网站加以使用，现在不仅整合 ChatGPT 当中，且以自然对话方式就能使用，这建立在MCP之上。首批上线的应用合作伙伴包含Booking.com、Canva、Coursera、Figma、Expedia、Spotify、Zillow。还有更多应用将在今年稍晚陆续推出，包含AllTrails、Khan Academy、Instacart、Peloton、Target、Tripadvisor、Uber。

八年首见，DRAM模组厂威刚、十铨暂停报价

10月9日爱集微消息，DRAM缺货大涨价狂潮挡不住，全球第二大存储器模组厂威刚（3260）、中国台湾存储器模组二哥十铨不约而同暂停报价，意味市况比外界预期更热，价格走势还会更高。威刚董事长陈立白10月7日高喊：本季是存储器大多头的起点，也是严重缺货的开始，2026年产业荣景可期。这是存储器模组业2017年以来，首次出现厂商暂停报价，意味市场严重供不应求，厂商看好价格还会继续飙，只能先盖牌惜售，借此创造最大化获利，并宣告这波DRAM涨价潮从南亚科、华邦等上游晶片端蔓延至下游模组端，整个产业链一片火热。这波DRAM狂潮，起因AI带动资料存储需求爆发，三星、SK海力士、美光等三大国际存储器制造商全力冲刺高带宽存储器（HBM），排挤DDR4、DDR5生产，甚至退出DDR4制造，但在终端需求对DDR4、DDR5不减反增、且力道强劲，DDR4价格率先拉出一波倍数涨幅，DDR5也跟进激昂，整个产业全面大复苏。由于严重缺货，市场疯狂追价囤货导致价格狂涨，美光、南亚科等DRAM厂先前都已陆续传出暂停报价，过往模组厂都在价格大幅波动时，多半透过，即先前囤积的低价库存与之后涨上来的现货价之间的价差套利，如今威刚、十铨转为主导暂停报价，显示市况比外界预期更热。

三星5奈米打造整合256亿个电晶体，IBM推出Spyre AI晶片解决方案

10月9日电子时报消息，蓝色巨人IBM 宣布，全面推出Spyre AI晶片，并正式投入商业应用。这是一款可达成企业低延迟推理的AI晶片，支持生成式和代理式AI应用，同时优先考虑核心工作执行的安全性和弹性。2025年稍早，IBM已经确认 Spyre AI晶片在z17、LinuxONE 5和Power11系统提供。IBM表示，当今的IT环境正在从传统的逻辑工作流程转变为代理AI推理，这需要低延迟推理和即时系统回应能力。同时还要确保核心数据、交易和应用程式的安全性与弹性，以支援客户将关键任务数据保留在本地，降低风险并提升能源和运营效率。IBM带来Spyre AI晶片，显示IBM从研究到产品的强大转化能力，并融合IBM研究院人工智慧硬体中心的突破性创新与IBM基础设施部门的企业级开发成果。Spyre AI加速器采用了三星5LPE制程技术来制造，核心面积为330平方公厘，整合了256亿个电晶体，是一款专门构建的企业级AI晶片，为复杂的AI模型和生成式AI用例提供可扩展的功能。

考虑英特尔晶圆代工，苏姿丰态度保守，强调与台积电深度合作

10月9日电子时报消息，近期市场频传有关AMD与英特尔可能合作的消息，在被问到这件事情的可能性，AMD执行长苏姿丰并未给出明确回应，而是采取较为模棱两可的态度回答。随着NVIDIA、软银及川普政府等实体都在投资英特尔，上周有报导指出，AMD正探索对英特尔的投资可能性，但讨论仍处于早期阶段。在被彭博社问到是否考虑让英特尔制造晶片时，苏姿丰表示，供应链是我们非常谨慎管理的部分。我们拥有非常强大的供应链，跟台积电也深度合作。当然，会优先考虑在美国本地建厂，这对AMD来说非常重要。这是美国的AI堆叠，我们也希望尽可能在美国完成更多环节。撇除政治因素外，AMD与英特尔的合作可能性不高，因为AMD在半导体领域已拥有一条完全由台积电打造的专用成熟供应链；另从产品竞争来看，因为AMD与英特尔在消费者市场及资料中心领域重叠，双方合作会带来更多复杂的状况，因此合作机会应相对有限。不过外媒WCCFTech推测，如果英特尔进展顺利，说不定AMD也会考虑双供应链策略（dual-sourcing）。

应材与贝思半导体合作，开发新整合式混合键合设备

10月9日电子时报消息，应用材料近日发表全新半导体制造系统，可提升AI运算所需的先进逻辑与记忆体晶片效能。新产品聚焦于研发更强大AI晶片的三大关键领域，即GAA等前瞻逻辑制程、HBM等高效能DRAM，以及用于打造高度整合系统级封装、优化晶片效能、功耗及成本的先进封装技术。应材指出，混合键合是一项新兴的晶片堆叠技术，采用直接铜对铜键合方式，可大幅改善整体效能、功耗及成本，但由于晶片封装日趋复杂，混合键合技术在大规模量产面临挑战。对此，应材与贝思半导体（Besi）合作，开发业界首创整合式裸晶对晶圆（die-to-wafer）的混合键合产品Kinex™ Bonding键合系统，该系统结合应材在晶圆和晶片前段制程的专业技术，以及贝思半导体领先的裸晶放置、互连与组装机高度精准与高速键合的解决方案。目前已有多家领先的逻辑、记忆体及委外封测业者（OSAT）采用Kinex系统。应材半导体产品事业群、异质整合产品技术副总裁郑心圆表示，在混合键合的过程中，表面处理（Surface Preparation）和黏着（Tacking）步骤是最为困难的，而Kinex系统将所有关键混合键合制程步骤整合于单一系统中，相较于非整合式方案具有多项重大优势。

美国议员呼吁扩大对华芯片制造设备出口禁令

10月10日爱集微消息，在了一项美国两党调查发现中国芯片制造商去年购买了价值380亿美元的先进设备后，美国议员呼吁对向中国出售芯片制造设备实施更广泛的禁令。美国众议院中国问题特别委员会周二发布的一份报告显示，美国、日本和荷兰发布的规则存在不一致，导致非美国芯片设备制造商向一些中国公司出售美国公司无法出售的产品。该委员会呼吁美国及其盟友对向中国出售芯片制造设备实施更广泛的禁令，而不是缩小对特定中国芯片制造商的销售范围。这380亿美元的禁令是从五大半导体制造设备供应商处购买的，并未违反法律，比2022年（当时许多设备出口限制措施出台）增长了66%。报告发现，这占应用材料公司、泛林集团、科磊、ASML和Tokyo Electron (TEL) 总销售额的近 39%。报告称：“这些销售额使中国在各种半导体制造领域竞争力日益增强，对世界各地的人权和民主价值观产生了深远影响。”美国民主党和共和党政府都试图限制中国制造微芯片的能力，微芯片对人工智能和军事现代化等领域至关重要。

奥特曼坚持找台积电生产晶片，暂不考虑英特尔代工

10月10日科技新报消息，人工智能大厂OpenAI执行长奥特曼（Sam Altman）近日对全球半导体供应链的未来发表了明确的见解，对科技大厂是否应将英特尔代工服务（Intel Foundry）视为台积电的替代方案，给出了果断的答案。奥特曼表示，他目前倾向于坚持与这家台湾晶圆代工巨头合作，而非立即转向英特尔。接受媒体采访时，奥特曼被问及半导体价值链有单一实体问题，以及是否有必要扩展市场供应链，例如考虑英特尔代工。奥特曼直接回应，他最希望看到台积电增加产能。是否认为有必要让台积电加速投资更多产能时，他也肯定答覆。奥特曼观点在业界有相当的分量，这是因为OpenAI虽然目前尚未参与晶片制造业务，但这家科技巨头正在开发一款专用的AI晶片，据称该晶片将采用台积电的3奈米制程，这显示Sam Altman对半导体供应链的动态有着深刻的理解。因此，对于是否应采取多晶片供应商的策略，他的声明透露出明确的偏好，就是依赖一个一致且稳定的合作伙伴，而非现阶段推行双重采购策略。不过，这并非是对英特尔的彻底排斥，而是一种优先顺序的表明。科技大厂普遍理解，仅靠台积电不够，致力美国本土制造是长期目标。尤其辉达（NVIDIA）和AMD都集中台积电生产，导致供应集中风险。

崇越9月营收首破60亿元大关，前三季度营收超越500亿元大关

10月10日科技新报消息，半导体设材料厂崇越科技公布9月营收，单月营收首度冲破60亿元大关，达60.9亿元，较8月份增加3.8亿元，成长6.6%。相较2024年同期，金额增加7.8亿元，成长达14.6%。前三季度累计营收达502.8亿元，较2024年同期增加22.4%。崇越科技表示，营运稳步推进，连续刷新历史高点，2025年9月攀上高峰，第三季营收再度改写新高，达175.4亿元，较第二季增加3.2%、较2025年同期也增加14.1%。在半导体市场需求热络及海外环保工程稳定挹注下，崇越科技展现强劲的成长动能，续创新猷。崇越科技强调，此次亮眼的营运表现，亦反映出公司持续深化国际布局的成果。崇越科技积极打造全球供应链平台，推动海外据点发展，强化在地服务能量。10月7日至9日，崇越科技于美国凤凰城盛大参展2025 SEMICON WEST半导体展，聚焦

展示半导体制程材料、设备、自动化系统与精密零组件，并携手来自日本、台湾共14家合作伙伴共同参展，展现全方位供应链整合实力。另外，随着亚利桑那成为先进制程晶圆制造重镇，北德州也逐步形成高度整合的半导体生态系，崇越科技已于两地设立据点，提供即时在地服务。崇越集团李正荣执行董事表示，除了亚利桑那及德州外，崇越科技亦派驻工程师至爱达荷州，协助国际记忆体大厂进行设备安装与零组件更换作业，预计2026年将于博伊西设立第三个营运据点，持续深耕并拓展美国市场版图。

助力企业高效AI运算，安图斯推新AI伺服器、工作站

10月10日科技新报消息，作为宏碁集团布局伺服器事业的关键角色，安图斯科技推出AI伺服器与工作站新产品，包含双路2U伺服器BrainSphere R380 F7 / R385 F6，以及高效能工作站BrainSphere P150 F10 / P330 F6 SE，大幅提升处理器核心数、GPU支援、记忆体频宽及I/O扩充性，为企业带来更强大运算效能与更高应用弹性。全新BrainSphere R380 F7大幅提升记忆体频宽与I/O扩展设计，效能与扩充性均有显著进化。它采用新一代 Intel Xeon 6700 / 6500系列处理器，搭配双CPU最多能支援144核心；同时配置2张NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell系列GPU，为AI训练、推论与大数据分析，包含代理式AI、实体AI及科学运算等，提供更高速的运算效能，成为金融、医疗、制造、科研等部署高性能运算的理想选择。另一款BrainSphere R385 F6专为庞大资料量与高度运算密集的AI与HPC场景打造，协助企业加速模型训练与推论应用。它搭载最新AMD EPYC 9004 / 9005系列处理器，单处理器就能支援高达128核心，具备12通道DDR5记忆体，同步支援2张NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell系列GPU，提供更强大的资料处理与多任务能力。

四、公司公告

信濠光电：关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的公告

公司9月29日发布公告，持有本公司股份20,596,541股（占本公司总股本比例10.14%）的大股东梁国豪先生所持有的本公司3,276,000股（占本公司总股本比例1.61%）将被广东省深圳市宝安区人民法院司法拍卖；本公司无控股股东、实际控制人，梁国豪先生不是本公司的第一大股东或其一致行动人，梁国豪先生本次所持有的部分本公司股份被司法拍卖不会导致本公司第一大股东发生变化，不会对本公司的正常生产经营、公司治理产生不利影响；本次司法拍卖事项存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

英集芯：英集芯关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的公告

公司9月30日发布公告，深圳英集芯科技股份有限公司于2025年9月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》等议案。根据《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“《激励计划（草案）》”）的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予价

格进行了调整，由 8.372 元/股调整为 8.282 元/股。

清溢光电：2025 年半年度权益分派实施公告

公司 9 月 30 日发布公告，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 314,800,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数 1,723,419 股后为 313,076,581 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利人民币 28,176,892.29 元（含税）。公司 2025 年半年度不进行资本公积转增股本，不送红股。2025 年半年度公司现金分红金额占公司 2025 年半年度合并报表归属母公司股东净利润的 30.61%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司利润分配基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

德邦科技：烟台德邦科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告

公司 9 月 30 日发布公告，根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司<2025 年度中期利润分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至本公告披露日，公司总股本为 142,240,000 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 1,489,971 股后的股本为 140,750,029 股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币 14,075,002.90 元（含税）。

广钢气体：2025 年半年度权益分派实施公告

公司 9 月 30 日发布公告，公司于 2025 年 8 月 8 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，并于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），截至本公告披露日，公司总股本 1,319,398,521 股，扣减公司库存股 371,205 股后，实际参与分配的股本数为 1,319,027,316 股，以此计算合计拟派发现金分红 48,804,010.69 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

寒武纪：设立募集资金专项账户签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

公司 10 月 1 日发布公告，经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1969 号），中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,334,946 股，每股发行价格为人民币 1,195.02 元，募集资金总额为 3,985,327,168.92 元，扣除各项发行费用人民币 32,171,304.93 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 3,953,155,863.99 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特

殊普通合伙) 审验并出具了“天健验[2025]294 号”《验资报告》。

瑞联新材：持股5%以上股东减持股份计划公告

公司10月8日发布公告，西安瑞联新材料股份有限公司披露，持股5.0003%的股东宁波国富永钰创业投资合伙企业计划因资金需要，在2025年10月30日至2026年1月29日期间通过集中竞价方式减持不超过100,800股，占公司总股本的0.0581%。国富永钰为在中国证券投资基金业协会备案的私募创投基金，已获适用创业投资基金股东减持政策，投资期限超过60个月，因此其减持总量不受比例限制。本次拟减持股份来自公司上市前所持股份经资本公积转增取得，减持价格将依市场行情确定，如期间发生除权除息事项将作相应调整。公告同时指出，国富永钰此前已履行相关锁定及减持承诺，且不存在不得减持的情形，本次计划为正常资金安排，不会对公司治理结构或控制权产生影响。

胜宏科技：关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告

公司10月9日发布公告，胜宏科技于2025年9月30日召开董事会会议，决定为规范和提高募集资金管理效率，在不影响项目建设和资金使用的前提下，由其全资子公司和孙公司在新加坡、越南和泰国开立募集资金专用账户，分别用于越南人工智能HDI项目和泰国高多层印制线路板项目的资金存储与使用。公司授权董事长或其代理人办理账户开立及签署监管协议等相关事宜，明确新设账户仅限募集资金用途，不得挪作他用，并将在开户及协议签署完成后按规定及时披露相关信息。

四会富仕：一致行动人被动稀释暨股份减持触及1%整数倍的提示性公告

公司10月9日发布公告，四会富仕电子科技股份有限公司公告称，因公司可转换债券“富仕转债”转股导致总股本增加，以及控股股东四会市明诚贸易有限公司及其一致行动人四会天诚同创投资合伙企业在2025年9月22日至9月30日期间合计减持公司股份50.56万股，四会明诚及一致行动人合计持股比例由63.8150%降至62.1965%，触及1%整数倍变动线。本次股权变动的原因包括部分股份被动稀释与主动减持，变动已履行此前预披露的减持计划，符合《证券法》等相关法律法规，不涉及控股权变更，也不会对公司治理结构或持续经营造成影响。

艾比森：2025年半年度权益分派实施公告

公司10月9日发布公告，深圳市艾比森光电股份有限公司宣布2025年半年度利润分配方案已于9月23日经临时股东大会审议通过，并将于10月15日股权登记、10月16日除权除息。公司以总股本3.691亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发7,382.01万元，不送红股、不转增股本。红利税按投资者身份及持股期限差异化征收，其中境外机构及港股通投资者税率为10%，个人投资者按持股期限分档补税。A股股东红利将由中国结算深圳分公司代为派发，部分股东由公司自行发放。除权除息参考价将相应下调0.2元，公司限制性股票激励计划的授予价格亦将按规定调整。

乾照光电：关于高级管理人员减持股份预披露公告

公司10月9日发布公告，厦门乾照光电股份有限公司高级管理人员刘兆和刘文

辉因个人资金需求，计划自公告披露15个交易日后的三个月内，通过集中竞价及大宗交易方式减持股份。刘兆持有公司股份146.13万股，拟减持不超过36.53万股，占公司总股本0.04%；刘文辉持有公司股份134万股，拟减持不超过33.5万股，占公司总股本0.04%。两人所减持股份均来自股权激励或个人买入股份。公司表示，本次减持不会影响控制权或公司治理结构，两位管理人员将根据市场情况决定是否实施，并承诺严格遵守相关法律法规并及时履行信息披露义务。

华润微：2025年半年度权益分派实施公告

公司10月10日发布公告，华润微电子有限公司2025年半年度利润分配方案已于9月19日召开的第三次临时股东大会审议通过，并将于10月16日股权登记、10月17日除权除息及发放红利。此次分红以公司总股本13.28亿股为基数，每股派发现金红利0.026元（含税），合计派发3,451.58万元，不涉及差异化分红送转。除华润集团微电子有限公司及华润股份有限公司的红利由公司自行派发外，其余股东红利由中国结算上海分公司代为发放。个人及基金投资者适用差别化红利税政策，境外机构及港股通投资者代扣税率为10%。公司强调本次分红符合相关法律法规，资金清算与派发安排已明确落实。

睿能科技：睿能科技股东平潭捷润减持股份计划公告

公司10月10日发布公告，福建睿能科技股份有限公司股东平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）计划因资金需求，于2025年11月1日至2026年1月31日期间通过集中竞价方式减持公司股份不超过200万股，占公司总股本的0.96%。截至公告日，平潭捷润持有公司股份952.53万股，占总股本的4.59%，系公司上市前员工持股平台，其所持股份来源包括IPO前取得及资本公积金转增股本形成的股份。平潭捷润承诺减持价格不低于发行价，减持比例在锁定期满后两年内不超过公司总股本5%，并将遵守相关法律法规及信息披露要求。公司表示，本次减持属于股东自主行为，不会影响公司控制权、治理结构或持续经营。

燕东微：关于持股5%以上股东调整减持股份计划之减持数量的公告

公司10月10日发布公告，北京燕东微电子股份有限公司表示，其持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司与北京京国瑞国企改革投资基金因公司总股本由12.03亿股增至14.28亿股，调整了此前披露的减持计划数量。两家股东原计划各减持不超过1,202.89万股，现调整为不超过1,427.62万股，减持比例均保持在公司总股本的1%以内。除减持数量外，减持期间为2025年7月31日至10月31日、减持方式及减持原因均未变。公司称本次调整符合相关法律法规，不涉及控制权变更，两家股东将依法依规履行信息披露义务。

五、下周重要事件提示

表 3：下周重要会议

行业会议

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	第九届国际先进光刻技术研讨会 (IWAPS 2025)	10.14-10.15	深圳市	中国集成电路创新联盟、中国光学学会
2	IEEE 第 25 届通信技术国际会议 (ICCT 2025)	10.16-10.18	沈阳市	IEEE 北京分会、IEEE 中国理事会、东北大学
3	第五届电气工程与机电一体化技术 国际学术会议 (ICEEMT 2025)	10.17-10.19	深圳市	南方科技大学

公司会议			
序号	公司名称	会议名称	会议时间
1	同兴达	股东大会举办	2025-10-17
2	汇创达	股东大会举办	2025-10-17
3	万祥科技	股东大会举办	2025-10-17
4	骏亚科技	股东大会举办	2025-10-17
5	晶华微	股东大会举办	2025-10-17
6	清越科技	股东大会举办	2025-10-17
7	艾森股份	股东大会举办	2025-10-17
8	超声电子	股东大会举办	2025-10-16
9	富瀚微	股东大会举办	2025-10-16
10	电连技术	股东大会举办	2025-10-16
11	东芯股份	股东大会举办	2025-10-16
12	恒烁股份	股东大会举办	2025-10-16
13	先锋精科	股东大会举办	2025-10-16
14	康冠科技	股东大会举办	2025-10-15
15	福晶科技	股东大会举办	2025-10-15
16	江海股份	股东大会举办	2025-10-15
17	捷荣技术	股东大会举办	2025-10-15
18	贝隆精密	股东大会举办	2025-10-15
19	闻泰科技	股东大会举办	2025-10-15
20	至正股份	股东大会举办	2025-10-15
21	龙芯中科	股东大会举办	2025-10-15
22	昀冢科技	股东大会举办	2025-10-15
23	影石创新	股东大会举办	2025-10-15
24	蓝箭电子	股东大会举办	2025-10-14
25	炬光科技	股东大会举办	2025-10-14
26	奥迪威	股东大会举办	2025-10-14
27	华塑控股	股东大会举办	2025-10-13
28	好上好	股东大会举办	2025-10-13
29	可立克	股东大会举办	2025-10-13
30	协创数据	股东大会举办	2025-10-13
31	鸿富瀚	股东大会举办	2025-10-13
32	聚辰股份	股东大会举办	2025-10-13
33	甬矽电子	股东大会举办	2025-10-13

34	富创精密	股东大会举办	2025-10-13
----	------	--------	------------

数据来源: Choice, 金元证券研究所

表 4: 电子行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		解售股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
300868.SZ	杰美特	2025-10-13	64.79	12,795.20	8,018.02	62.66	8,082.82	63.17	股权激励限售股份
002922.SZ	伊戈尔	2025-10-13	8.80	42,310.31	37,524.60	88.69	37,533.40	88.71	股权激励限售股份
688525.SH	佰维存储	2025-10-13	3,002.53	46,670.83	32,274.70	69.15	35,277.23	75.59	定向增发机构配售股份
688153.SH	唯捷创芯	2025-10-13	23,940.30	43,031.30	16,921.64	39.32	40,861.94	94.96	追加承诺限售股份上市流通
603052.SH	可川科技	2025-10-13	13,143.76	18,789.73	5,645.97	30.05	18,789.73	100.00	首发原股东限售股份
603986.SH	兆易创新	2025-10-14	96.17	66,727.80	66,627.71	99.85	66,723.88	99.99	股权激励期权行权
001309.SZ	德明利	2025-10-14	62.42	22,688.63	16,038.19	70.69	16,100.61	70.96	股权激励限售股份
688141.SH	杰华特	2025-10-15	344.16	44,688.00	26,394.62	59.06	26,738.78	59.83	股权激励一般股份
002938.SZ	鹏鼎控股	2025-10-15	284.10	231,805.10	230,678.18	99.51	230,962.27	99.64	股权激励限售股份
003043.SZ	华亚智能	2025-10-17	912.47	13,399.03	7,983.31	59.58	8,895.79	66.39	定向增发机构配售股份
300433.SZ	蓝思科技	2025-10-17	470.30	528,432.76	496,731.34	94.00	497,201.64	94.09	股权激励限售股份

数据来源: Choice, 金元证券研究所

金元证券行业投资评级标准：

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。